



DER ARBEITSKREIS

Bereits seit 2005 treffen sich Experten der Elektronikbranche drei mal jährlich und tauschen sich über die Europäischen Gesetzgebungen im Bereich Umwelt und Elektronik aus. RoHS und WEEE sind regelmäßigen Änderungen unterworfen, die Anforderungen der europäischen Ökodesign-Richtlinie (ErP) sowie der EU-Energieverbrauchskennzeichnung werden auf immer mehr Produktgruppen ausgeweitet, und REACH/CLP stellt die Zulieferkette und das Datenmanagement vor erhebliche Herausforderungen. Die nationale Umsetzung in der ElektroStoffV, dem ElektroG und dem EVPG, sowie globale Entwicklungen und die einschlägigen Normen (EN 50581, EN 62474, ...) erfordern eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Materie.

Auf den Treffen werden der aktuelle Stand der nationalen und internationalen Gesetzgebung behandelt, Methoden und Werkzeuge für die Entwicklung umweltgerechter Produkte und zur Deklaration von Inhaltsstoffen vorgestellt und an Beispielen erläutert.

MITGLIEDER

Mitglieder des Arbeitskreises sind vor allem Firmen aus den Bereichen Telekommunikation, Industrieelektronik, der Mess- und Regelungstechnik, Komponentenherstellung und Softwareentwicklung. Zu den weiteren Mitgliedern gehören Vertreter von Verbänden, Dienstleistungsunternehmen der Bereiche Inspektion, Test, Verifizierung & Zertifizierung, Rechtsanwaltskanzleien sowie Behörden und Ministerien.

VERANSTALTUNGORT

Technische Universität Berlin
Forschungsschwerpunkt Technologien der Mikroperipherik
Gebäude 17a, Treppe 5, 2.OG, Raum 294
Gustav-Meyer-Allee 25 , 13355 Berlin

Abweichender Veranstaltungsort am 4.11.14:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin

TEILNAHMEGEBÜHR

Für die Jahresmitgliedschaft werden pro Unternehmen und Standort 995,00 € berechnet, der Betrag ist gemäß § 4 Nr. 22 UStG umsatzsteuerfrei. Der Mitgliedsbeitrag schließt die Teilnahme an jährlich drei Treffen des Arbeitskreises ein sowie Tagungsunterlagen, Mittagessen, und Pausengetränke. Mitglieder erhalten zudem Zugang zum passwortgeschützten Downloadbereich mit Präsentationen und dem Archiv der Vortragsunterlagen vergangener Treffen.

ANMELDUNG

Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer Mitgliedschaft über unser Online-System an: <http://ak-weee.izm.fhg.de>

KONTAKT

Karsten Schischke
Fraunhofer IZM | Gustav-Meyer-Allee 25 | 13355 Berlin
Tel.: +49 30 46403156 | karsten.schischke@izm.fraunhofer.de

ARBEITSKREIS RICHTLINIENKONFORMES DESIGN FÜR WEEE / ROHS / ERP





Institutsleiter Prof. Lang mit Gästen



Treffen des Arbeitskreises im BMWi 2008

DIENSTAG, 18. FEBRUAR 2014

- 10:00** **Aktuelles aus der Gesetzgebung**
Nils Nissen, Fraunhofer IZM
- 10:30** **Die REACH-Kandidatenliste aus Sicht der Distribution - Strukturen und Funktionen von SVHC**
Oliver Senkel, Avnet
- 11:10** **Bleifrei total – Konsequenzen für die Industrie**
Bodo Eilken, Infineon
- 11:50** **Stand der Zertifizierung von Konfliktmineralien**
Gudrun Franken, BGR
Mittagspause
- 13:30** **Auswirkungen der REACH, RoHS und POP-Regulierungen auf den Einsatz recycelter Kunststoffe in Elektronikgeräten**
Chris Slijkhuis, Müller-Guttenbrunn GmbH
- 14:10** **Was bringt das HTV-Life-Prüfzeichen gegen geplante Lebensdauerbegrenzende Schwachstellen in Produkten?**
Holger Krumme, HTV
- 14:40** **Wie kann die Langzeitverfügbarkeit von Elektronikkomponenten sichergestellt werden? Speziallagerverfahren im Vergleich**
Holger Krumme, HTV
- 15:30** **Lebensdauer von Akkus mobiler IT-Geräte**
Krystan Marquardt, Fraunhofer IZM / TU Berlin
- 16:00** **Recycling- und Reparatureignung von Tablets**
Gergana Dimitrova, Fraunhofer IZM
- 16:20** **Abschließende Diskussion**
- 16:40** **Veranstaltungsende**

DIENSTAG, 3. JUNI 2014

- 10:00** **Aktuelles aus der Gesetzgebung**
Nils Nissen, Fraunhofer IZM
- 10:30** **Elektrogeräte und Ressourceneffizienz: Die Umsetzung der neuen WEEE-Richtlinie im ElektroG 2 (angefragt)**
Heike Buschhorn, Umweltministerium Niedersachsen
- 11:00** **WEEE-Recast: Konkrete Neuregelungen im Überblick, Chancen und Risiken aus Herstellersicht**
Peter Cossé, Toshiba Europe GmbH
- 11:30** **Substitution von Ag/CdO-Kontaktwerkstoffen für Schalter und Relais vor dem Hintergrund von RoHS II, REACH, SVHC und ELV**
Volker Behrens, Doduco GmbH
- 12:10** **Europäische Anforderungen an das Management von Konfliktmineralien**
Andreas Schifflleitner, iPoint
Mittagspause
- 13:40** **Auswirkungen aktueller Entwicklungen der REACH und RoHS auf den Flammhemmereinsatz in Elektro- und Elektronikgeräten**
Florian Kohl, EFRA
- 14:20** **Die REACH in der Automobilindustrie: Praxiserfahrungen und Umsetzungsbeispiele**
Hans Pfeil, Ford-Werke GmbH
- 15:20** **RoHS-Konformität von Produkten der Prozess- und Fabrikautomation - Erfahrungen mit dem Umstellungsprozess**
Barbara Duve, Festo AG & Co. KG
- 16:00** **Überprüfung der Energieverbrauchskennzeichnung von Fernsehern in Europa**
Alexander Schlösser, TU Berlin
- 16:20** **Abschließende Diskussion**
- 16:40** **Veranstaltungsende**

DIENSTAG, 4. NOVEMBER 2014

- 10:00** **Begrüßung durch das Bundeswirtschaftsministerium**
- 10:10** **Aktuelles aus der Gesetzgebung**
Nils Nissen, Fraunhofer IZM
- 10:40** **Stand der Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie aus Sicht des BMWi: Erfahrungen, aktuelle Anforderungen und Einschätzungen zur künftigen Weiterentwicklung**
Arne Küper, Bundeswirtschaftsministerium
- 11:20** **ErP-Ökodesignanforderungen an Server**
Lutz Stobbe, Fraunhofer IZM
- 12:00** **Galliumarsenid: Stand der Regulierung unter der REACH**
N.N., TU Berlin
Mittagspause
- 13:40** **Umsetzung der REACH in Forschung und Entwicklung**
N.N., Fraunhofer
- 14:20** **Auswirkungen der Umweltgesetzgebung auf industrielle Anwendungen: Effizienzanforderungen an Motoren und Umsetzung der RoHS**
Gunther Koschnick, ZVEI (angefragt)
- 15:20** **Product Environmental Footprint: Erste Erfahrungen aus der Pilotphase**
Jan Berger, Bundesumweltministerium
- 15:50** **Tests von IKT-Geräten hinsichtlich Umweltverträglichkeit durch die Stiftung Warentest: Erfahrungen, relevante Substanzen und Ausblick auf künftige Testkriterien**
Jürgen Nadler, Stiftung Warentest (angefragt)
- 16:20** **Abschließende Diskussion**
- 16:40** **Veranstaltungsende**